

金发科技股份有限公司关于拟发行债券、资产支持证券 及非金融企业债务融资工具的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年4月24日，公司召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟发行债券、资产支持证券及非金融企业债务融资工具的议案》。为优化债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟发行非金融企业债务融资工具、公司债、企业债、资产支持证券、自贸区和境外债券等（以下统称“融资工具”），合计金额不超过人民币60亿元（含60亿元），发行方案如下：

一、发行品种

1、非金融企业债务融资工具，包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据、永续中票、非公开定向债务融资工具等；

2、公司债；

3、自贸区和境外债券；

4、企业债；

5、资产支持证券。

二、发行规模

上述融资工具的发行总规模不超过人民币60亿元（含60亿元）。

三、期限

发行的期限不超过10年（含10年）。

四、发行方式

1、以公开或非公开方式募集发行；

2、根据实际资金需求及市场情况，一次性或分期发行。

五、募集资金用途

本次融资工具募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金、项目投资建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

六、决议有效期

本次发行决议的有效期为股东大会通过之日起 24 个月。

七、授权事项

提请股东大会授权董事会根据公司需要和市场条件在上述方案内，全权决定和办理与发行融资工具有关的事宜。若该议案获得股东大会通过，董事会同意授权董事长或董事长授权的其他人士确定和实施发行债务融资工具的具体方案，包括但不限于：确定发行方案如发行品种、发行时机、发行额度、发行期限、批次结构、资金用途等；起草、修改、签署并向有关部门或机构提交各项与发行有关的申请、报告或材料；决定并聘请参与本次发行的相关中介机构；办理必要的手续，进行相关的信息披露；根据法律规定和监管机构的审核意见对本次发行的具体条件及相关发行方案进行修订和调整等。

本授权自获得公司股东大会批准之日起至融资工具资格获批后注册有效期失效为止。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日